

はんだクラック発生防止を目的としたハイブリッド基板のご紹介

エルナー株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:吉田 秀俊、以下 当社)は、様々なニーズにお応えする商品を展開しています。そのラインナップより、はんだクラック発生防止を目的としたハイブリッド基板(*1)についてご紹介致します。

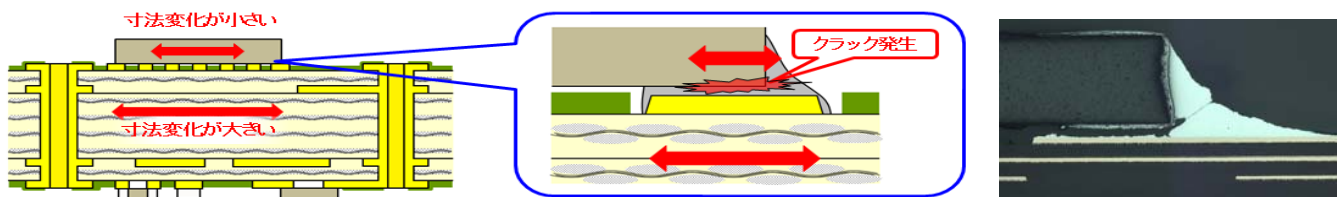
一般的にセラミック部品(モジュールやパッケージなど)が実装された基板では、その物性値の違いから部品と基板を接合するはんだにクラックが発生し、接合信頼性が低下するという問題があります。これまで、様々な視点でこの問題に対して対策がなされていますが、昨今のセラミック部品の高性能化、高機能化にともない、部品の大型化や端子形状が変化したことにより、対策が困難となるケースが増えてきました。

当社は、これを対策するものとして、はんだクラック発生の主な原因である環境変化(温度や湿度など)において部品と基板の熱挙動差から生じるはんだへの負荷を低減し、はんだクラックの発生を防止(抑制)するハイブリッド基板を新たに開発いたしました。

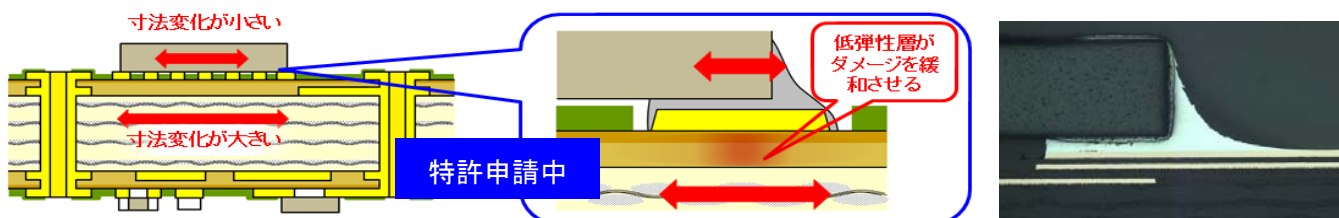
当製品の効果は、セラミック部品のサイズ、端子形状、基板仕様などにより異なりますが、用途を問わず様々なニーズに対応できるようにカスタム性を充実させ、最適なタイプをご提案し、一層の拡販に取り組んでまいります。

<開発製品内容>

■一般的な基板 環境変化において、セラミック部品と基板の熱挙動差により、はんだクラックが発生



■開発製品: ハイブリッド基板 はんだクラックの発生を防止(抑制)



・*独自の設計ノウハウ、材料選択により、セラミック部品と基板の熱挙動差によるはんだへのダメージを緩和。

*1:ハイブリッド基板とは、複数の異なる特性の基材を組み合わせた多層プリント配線板です。

<本件に関するお問い合わせ先>

エルナー株式会社 プリント回路事業本部営業統括部

担当 奥長茂樹

電話 045-470-7268